

LC-2QS252

HDI・パッケージプリント配線板向け
高速高精度C02レーザ加工機

2Panel/2Beam Laser Drilling Machine



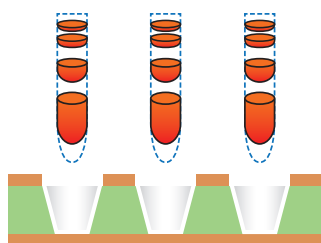
内製コア技術を結集し、安定した高速、高精度、高品質加工を実現

□次世代プリント配線板の量産をサポートする長期安定性

- ・自社製の発振器とRF電源により、レーザー出力の安定性を向上。
- ・自社製のガルバノシステム、CNC制御システム、ソフトウェアにより高速・高精度加工を実現。
- ・使用環境への適応技術により、長期安定性が可能。
汎用ビルトアップ製品から半導体インターポーザ製品まで幅広く、安定した量産を、高速、高精度、高品質で実現出来ます。

□独自モジュレーション機能を更にグレードアップ

内層薄銅箔加工時（3層板加工）の熱影響回避に大きな効果を発するモジュレーション機能が更に進化。
レーザーの1パルス発振を、3条件のモジュレーション設定で制御可能、生産性向上と高い加工品質確保の両立を実現しました。

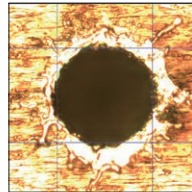


Step Pulse + Modulation Drilling

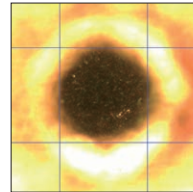
ショット数削減による加工速度の向上と内層ダメージのない高品質加工の両立を実現

3Layer 加工

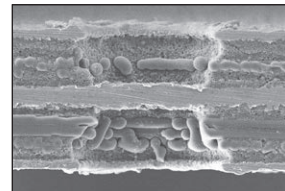
Front top view



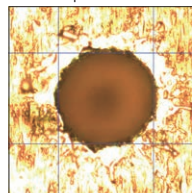
Front bottom view



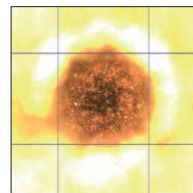
Cross section



Back top view

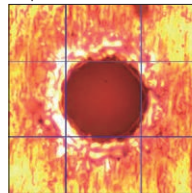


Back bottom view

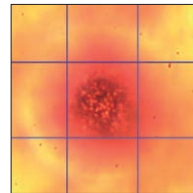


未処理Cuダイレクト加工 加工径 25μm

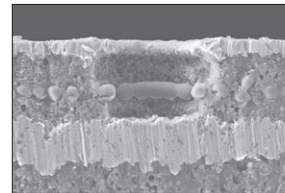
Top view



Bottom view



Cross section



□次世代高密度配線板の高精度加工対応

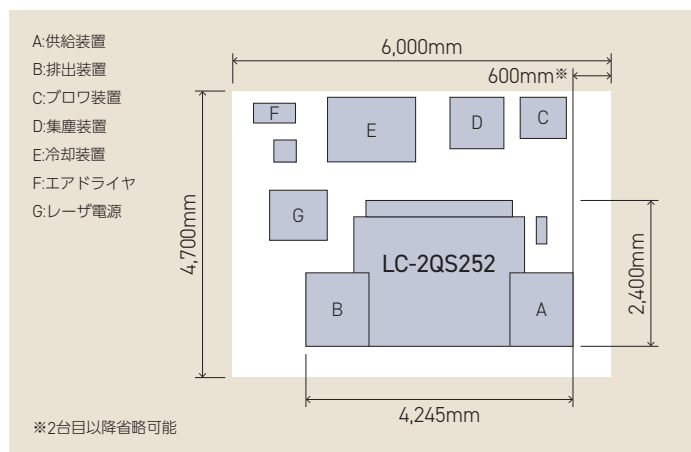
ハイエンド半導体用インターポーザ向けプリント配線板用のレーザー加工機で築き上げた機械構造物解析技術、熱解析技術、高精度位置決め技術を基に、更なる加工精度を向上。
精度評価治具への加工でAve+3σ ≤ 6μmを実現。

主仕様

型 式	LC-2QS252
最大加工エリア	635×813mm 2/パネル
XY早送り速度	50m/min
加工ヘッド数	2
レーザー出力	640W
スキャンエリア	□ 70mm (OPTION : □ 30mm, □ 50mm)
加工精度	±0.008mm (Via/パターン) Ave.+3σ ≤ 6μm (ガラスマスタ) ※1
数値制御装置	MARK-55L +

※1 オプション

設置スペース



※本カタログの内容は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。



ビアメカニクス株式会社

本社／東日本営業部：〒243-0016 神奈川県厚木市田村町9番32号 TEL.046-203-9688 FAX.046-203-9690
西日本営業部：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目6番15号 TEL.052-262-0621 FAX.052-262-0625
御殿場工場：〒412-0006 静岡県御殿場市中畑1656番1 TEL.0550-20-1020 FAX.0550-20-1021
<https://www.viamechanics.com>

